

ZESTRON® VD

Medium für die Flussmittelentfernung in der Elektronikfertigung für wasserfreie Prozesse



ZESTRON® VD ist ein lösemittelbasierendes Medium zur wasserfreien Flussmittelentfernung von elektronischen Baugruppen, Keramik-substraten, Powermodulen und Leadframes in geschlossenen Kreislaufprozessen auch mit Dampfspülung unter Vakuum.

Anwendungsbereiche: Baugruppen, Keramiksubstrate & Leadframes		Weitere Informationen zum Produkt:
Feststoffarme Flussmittel*	+	Technische Information 2: Übersicht aller getesteten Flussmittel, SMT-Kleber und Lotpasten Technische Information 3: Übersicht bzgl. der Materialverträglichkeit Anwendungsempfehlung: Einsatzparameter des Mediums für die Reinigung
Kolophonium-Flussmittel*	+	
Wasserlösliche Flussmittel*	0	
Lotpasten (ungelötet)	++	
SMT-Kleber bzw. Leitkleber	+	
Dickfilmpasten	+	

++ sehr empfohlen + empfohlen 0 möglich, aber nicht empfohlen - nicht empfohlen

* Gilt für alle Standard- und Bleifreilote

Technische Zentren - ① Amerika, ② Europa, ③ Malaysia, ④ Nord-China, ⑤ Süd-China Lösungen für Reinigungsprozesse unter Produktionsbedingungen



Kontaktieren Sie ZESTRON's Prozessingenieure für kostenlose Reinigungsversuche:
Telefon: +49-841-635-26; E-Mail: techsupport@zestron.com

Vorteile gegenüber anderen Reinigungsmedien

- Durch seine polaren und unpolaren Bestandteile hat es einen breiten Anwendungsbereich für unterschiedlichste Verschmutzungen.
- Einheitlich destillierbar und damit in Einkammer-Lösemittelprozessen mit Dampfspülung unter Vakuum einsetzbar.
- ZESTRON® VD enthält keinerlei Tenside und trocknet daher garantiert rückstandsfrei.
- ZESTRON® VD eignet sich besonders für wasserfreie Anwendungen, in denen eine Spülung mit Wasser unerwünscht ist.
- Besonders für die Reinigung von Kapillarräumen (z.B. unter BGAs oder Flip Chips) geeignet.
- ZESTRON® VD kann ebenfalls zur Reinigung von Schablonen in Lösemittelanlagen und Druckern eingesetzt werden.

Vor der Reinigung von Kunststoffteilen bitte unser technisches Informationsblatt 3 einsehen.

ZESTRON® VD ist von allen führenden Herstellern von Reinigungsanlagen sowie Schablonen für den Einsatz freigegeben. Einzelfreigaben können angefordert werden.

Prozesse	1. Reinigen	2. Spülen	3. Trocknen
Geschlossene Kreislaufprozesse mit Dampfspülung	ZESTRON® VD	ZESTRON® VD	Vakuum
Ex-geschützte Sprühanlagen	ZESTRON® VD	ZESTRON® VD	Umluft oder Druckluft

Technische Daten		Prozessschema
Dichte	(g/ccm) bei 20°C	0,88
Oberflächenspannung	(mN/m) bei 25°C	26,3
Siedetemperatur	°C	170 - 175
Flammpunkt	°C	62
pH-Wert	10g/l H ₂ O	Neutral
Dampfdruck	(mbar) bei 20°C	1,0
Anwendungstemperatur	°C	40 - 45
Wasserlöslichkeit		Unlöslich
Einsatzkonzentration	Fertigmischung	Unverdünnt

PRODUCT FEATURES



Umfangreich getestet und zur Reinigung von bleifreien Lotpasten geeignet



Das Produkt ist frei von bedenklichen Inhaltsstoffen gemäß der SIN- & SVHC-Listen



100% konform mit den EU Richtlinien (RoHS 1 & 2, WEEE)

Umwelt- und Arbeitsschutz

- ZESTRON® VD ist lösemittelbasierend und biologisch abbaubar.
- Der Reiniger ist frei von halogenierten Verbindungen formuliert und damit besonders umweltverträglich.
- Für den Einsatz am Arbeitsplatz beachten Sie bitte die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Verfügbarkeit/Lagerung

- ZESTRON® VD ist in der fertigen Mischung in den Gebindegrößen von 1L, 5L, 25L und 200L verfügbar.
- Das Produkt unterliegt nicht der Gefahrgutverordnung.
- Es wird empfohlen ZESTRON® VD im Originalgebilde, in einem Temperaturbereich von 5°C - 30°C zu lagern.
- Luftdicht verschlossen ist das Produkt unter diesen Bedingungen mindestens 5 Jahre haltbar.

Entsorgung

- Gebrauchte Reinigungsmedien werden im Originalgebilde vom Hersteller zurückgenommen.

Reinheitsstandards

Baugruppen, die in einem Prozess mit ZESTRON® VD gereinigt werden, erreichen die Anforderungen der nachstehenden Standards:

- Optische Reinheit nach IPC-A-610
- Ionische Reinheit und Harzreinheit nach J-STD 001
- Oberflächenwiderstand IPC-TM-650 und DIN 32513
- Lötbarkeit nach J-STD 003

Alternative Produktempfehlung

- Für die Flussmittelenfernung mit einem wasserbasierenden Medium in Tauchanlagen empfehlen wir VIGON® US, für die Reinigung in Sprühprozessen VIGON® A 201.